



Tg(DSC) 175°C
Td(TGA) 355°C
CTI≥600V
(R-156AS*, R-156YS)

※板厚0.8mm以下

用途
オートモーティブ
 車載ECU、車載モジュール、HEV/EV パワーコントロールユニット、DC/DCコンバータ用基板など



Halogen-free

Laminate

R-156AS R-156YS

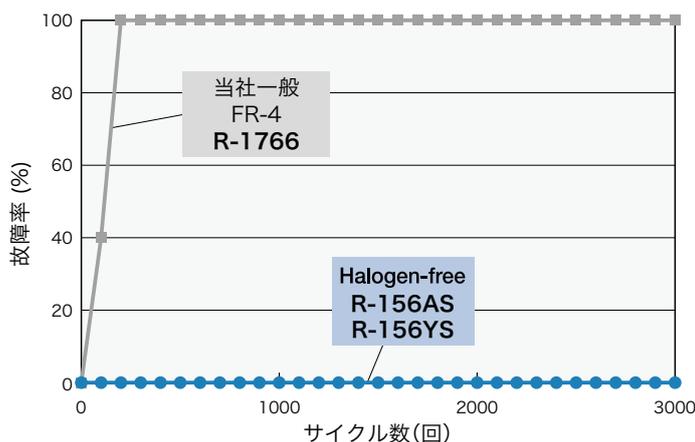
Prepreg

R-155AS R-155YS

高耐熱ハロゲンフリー多層基板材料

従来のR-1566より高耐熱性と耐トラッキング性を向上し、高温環境下で使用されるECU用基板の信頼性に貢献

スルーホール導通信頼性

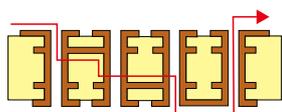


評価条件

サイクル条件	-40°C ⇄ 160°C (15分) ⇄ (15分)
--------	--------------------------------

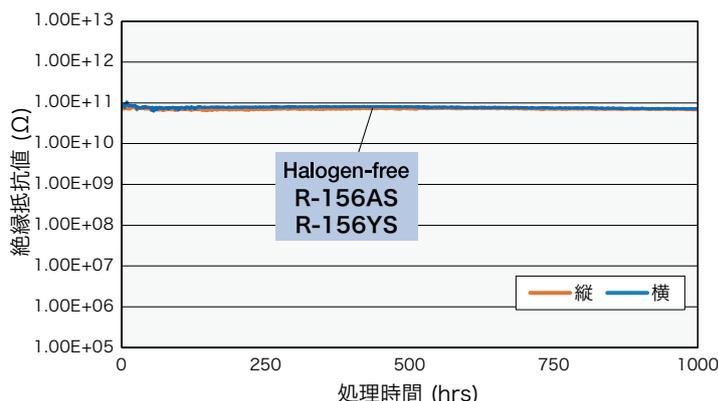
- ・NG判定：抵抗変化率 10%以上
- ・前処理：260°Cピークリフロー x3回

構成



絶縁信頼性

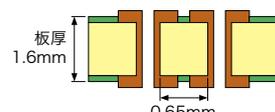
高電圧CAF評価



評価条件

前処理	260°Cピークリフロー x3回
評価条件	85°C 85%RH DC 350V
スルーホール壁間距離	0.65mm

構成



一般特性

項目	試験方法	条件	単位	Halogen-free R-156AS	Halogen-free R-156YS	当社一般ハロゲンフリー R-1566(W)
ガラス転移温度(Tg)	DSC	A	°C	175		148
	TMA			170		145
熱分解温度(Td)	TGA	A	°C	355		350
熱膨張係数(厚さ方向)	IPC-TM-650 2.4.24	A	ppm/°C	40		40
				180		180
T288(銅付)	IPC-TM-650 2.4.24.1	A	分	10		3
銅箔引き剥がし強さ	1oz(35μm) IPC-TM-650 2.4.8	A	kN/m	1.6		1.8
耐燃性	UL Method	C-48/23/50	—	94V-0*1	94V-1	94V-0

試験片の厚さは0.8mmです。
 ※1 厚み0.8mm上限

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

当社ハロゲンフリー材料は、JPCA-ES-01-2003などの定義によるものです。
 上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。

industrial.panasonic.com/jp/electronic-materials

Panasonic Industry R-156AS

パナソニック インダストリー株式会社 電子材料事業部

© Panasonic Industry Co., Ltd. 2025/08